

あらゆるアプリケーションに対応する SCREENの先進パターニング技術

拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
私ども(株)SCREENセミコンダクターソリューションズは、
ネプコンジャパン2017の「半導体パッケージング技術展」に出展いたします。
“SCREEN Advanced Patterning Technology”をコンセプトに、
直接描画・印刷・塗布など、SCREENが長年培ってきたさまざまな技術で、
あらゆるアプリケーションのパターニング工程に幅広く対応する
最新の装置を詳しくご紹介します。
この機会にぜひ弊社ブースにお越しいただき、最先端のテクノロジーをご実感ください。
何卒よろしくお願いいたします。 敬具

SCREEN
**Advanced Patterning
Technology**

第46回 ネプコン ジャパン 2017 第18回 半導体パッケージング技術展

ICP

【会期】2017年1月18日(水)~20日(金) 10:00~18:00(最終日のみ17:00まで)

【会場】東京ビッグサイト 【ブース】西1ホール W1-34

出展内容のご案内

アドバンスドパッケージ

大型パネル用直接描画装置

DW-3000 **NEW**
for PLP

世界最先端
「2.0μm解像」のパネル向け
直接描画露光装置。



株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ

Direct
Imaging

高密度プリント配線板

直接描画装置

Ledia 6

フォトマスクを使用せず、
さまざまな感光材料を
高速・高精度に露光。



株式会社 SCREEN グラフィックアンドプレジジョンソリューションズ

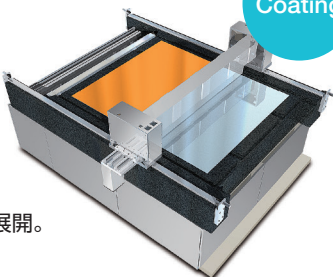
Direct
Imaging

アドバンスドパッケージ

パネルレベルスリットコーター

LC-M550G

世界シェアNo.1
スリット式塗布装置を
「パネルレベルパッケージ」向けに展開。



株式会社 SCREEN ファインテックソリューションズ

Coating

タッチセンサ、FHE

超精密グラビアオフセット枚葉式印刷装置

UP-5000S

安定した量産品質を実現。
細線プリンティングの
最新鋭ツール。



株式会社 SCREEN ホールディングス

Printing

同時開催の展示会「オートモーティブ ワールド 2017」では、当社の鍛造部品自動外観検査装置 IM-3100 を出展いたします。